



2021年9月30日

各 位

会社名 株式会社 S U M C O
代表者名 代表取締役 会長兼 CEO 橋本 眞幸
(コード: 3 4 3 6 東証第一部)
問合せ先 広報・IR室長 澁谷 博史
(TEL. 03-5444-3915)

新株式発行に関するお知らせ

当社は、2021年9月30日開催の取締役会において、下記のとおり、公募による新株式発行について決議いたしましたので、お知らせいたします。

【本資金調達目的】

当社グループは、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献しております。

特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の強化・向上に傾注し、半導体用シリコンウェーハ業界における地位の向上を図っております。

300mm 半導体用シリコンウェーハの需要は、5G・スマートフォン・データセンター・車載向け半導体等の強い需要の継続を背景に、今後も堅調に拡大することが見込まれます。現状の当社グループの製造設備では供給が需要に追いつかない状況となっており、特に、半導体デバイスの性能向上を牽引する最先端のテクノロジーに対応した 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ市場は、より高い成長が見込まれています。

かかる状況を踏まえ当社は、その時々における 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ市場の需給予想や製造設備の新設・増設に要する時間等を考慮しながら、顧客に対する供給責任を果たすために顧客の需要に応じた段階的な増産（以下「逐次増産」という。）を適切に実施する方針を継続してまいります。また、今後の逐次増産は、経済合理性のある価格と従来の長期販売契約（2～3年程度）よりも長期間の契約に応じて頂ける顧客に対する供給を優先して実施してまいります。

最先端半導体の微細化技術は絶えず進化しており、新しいテクノロジーに対応した 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハに要求される技術及び品質に対する顧客の要求はますます厳しくなっております。これらの要求水準を満たす製造ラインを構築するには、従来よりも高精度・高性能で且つ高額な製造加工装置及び検査装置等の関連設備を導入することが必要となります。

今回の資金調達は、当社グループの国内既存建屋内における増産スペースが尽きていることから、新たに建屋及びユーティリティ設備を建設した上で、逐次増産に対応できるよう製造設備を導入し、順次生産を開始できる体制を構築することを目的としております。

また、当社は、持続的な企業価値向上のために必要不可欠な、健全な財務基盤を構築するべく財務体質の改善に努めてまいりました。今回、設備投資資金については、その一部を公募増資により調達することで、事業運営に必要な財務健全性や柔軟性を損なうことなく、継続的な逐次増産が可

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

能となることから、中長期的な企業価値の向上に資すると考えております。

なお、設備投資の詳細につきましては、2021年9月30日付で公表いたしました「設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ」をご参照ください。

記

公募による新株式発行

- (1) 募集株式の種類及び数 下記①乃至③の合計による当社普通株式 60,000,000株
① 下記(4)①に記載の国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 15,000,000株
② 下記(4)②に記載の海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 37,174,000株
③ 下記(4)②に記載の海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株式の上限として当社普通株式 7,826,000株
- (2) 払込金額の決定方法 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2021年10月12日(火)から2021年10月15日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。
- (3) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
- (4) 募集方法 国内及び海外における同時募集とする。
① 国内一般募集
国内における募集(以下「国内一般募集」という。)は一般募集とし、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社を共同主幹事会社とする引受人(以下「国内引受会社」という。)に、国内一般募集に係る全株式を買取引受けさせる。
② 海外募集
海外における募集(以下「海外募集」という。)は海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。)における募集とし、Morgan Stanley & Co. International plc、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びGoldman Sachs Internationalを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする引受人(以下「海外引受会社」という。)に、海外募集に係る全株式を総額個別買取引受けさせる。また、海外引受会社に対して上記(1)③記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利を付与する。
なお、上記①及び②に記載の各募集に係る株式数については、国内一般募集15,000,000株及び海外募集45,000,000株(上記(1)②に記載の買取引受けの対象株式37,174,000株及び上記(1)③に記載の追加的に発行する当社普通株式を取得する権利の対象株式7,826,000株)を目処に募集を行うが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。
また、上記①及び②に記載の各募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。

国内一般募集及び海外募集のジョイント・グローバル・コーディネーターは、Morgan Stanley & Co. International plc、SMB C日興証券株式会社及びゴールドマン・サックス証券株式会社とする。

- (5) 引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして国内一般募集及び海外募集における発行価格(募集価格)と引受人より当社に払い込まれる金額である払込金額との差額の総額を引受人の手取金とする。
- (6) 申込期間(国内一般募集) 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで。
- (7) 払込期日 2021年10月18日(月)から2021年10月21日(木)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の4営業日後の日とする。
- (8) 申込証拠金 1株につき発行価格(募集価格)と同一の金額とする。
- (9) 申込株数単位 100株
- (10) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、発行価格(募集価格)、その他公募による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、当社代表取締役会長兼CEO橋本眞幸又はその選任する代理人に一任する。
- (11) 国内一般募集については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

〈ご参考〉

1. 今回の公募による新株式発行に伴う発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数(2021年9月30日現在)	290,175,139株
公募による新株式発行に伴う増加株式数	60,000,000株(注)
公募による新株式発行後の発行済株式総数	350,175,139株(注)

(注)上記「公募による新株式発行」(1)③記載の権利全部を海外引受会社が行使した場合の数字です。

2. 調達資金の用途

(1) 今回調達資金の用途

今回の国内一般募集及び海外募集による手取概算額合計上限127,969,000,000円については、786億円を2023年12月末までに当社の国内製造拠点(佐賀県伊万里市)における建屋及びユーティリティ設備に関連する設備投資資金に、残額を当該建屋における当社の300mm半導体用最先端シリコンウェーハの製造設備のための設備投資資金として2024年12月末までに充当する予定であります。

上記手取金は、具体的な充当期期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

当社グループの300mm半導体用最先端シリコンウェーハの増強投資の方針について

当社グループは、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口徑から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献しております。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の強化・向上に傾注し、半導体用シリコンウェーハ業界における地位の向上を図っております。

300mm 半導体用シリコンウェーハの需要は、5G・スマートフォン・データセンター・車載向け半導体等の強い需要の継続を背景に、今後も堅調に拡大することが見込まれます。現状の当社グループの製造設備では供給が需要に追いつかない状況となっており、特に、半導体デバイスの性能向上を牽引する最先端のテクノロジーに対応した 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ市場は、より高い成長が見込まれています。

かかる状況を踏まえ当社は、その時々における 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハ市場の需給予想や製造設備の新設・増設に要する時間等を考慮しながら、顧客に対する供給責任を果たすために顧客の需要に応じた段階的な増産（逐次増産）を適切に実施する方針を継続してまいります。また、今後の逐次増産は、経済合理性のある価格と従来の長期販売契約（2～3年程度）よりも長期間の契約に応じて頂ける顧客に対する供給を優先して実施してまいります。

最先端半導体の微細化技術は絶えず進化しており、新しいテクノロジーに対応した 300mm 半導体用最先端シリコンウェーハに要求される技術及び品質に対する顧客の要求はますます厳しくなっております。これらの要求水準を満たす製造ラインを構築するには、従来よりも高精度・高性能で且つ高額な製造加工装置及び検査装置等の関連設備を導入することが必要となります。

今回の資金調達は、当社グループの国内既存建屋内における増産スペースが尽きていることから、新たに建屋及びユーティリティ設備を建設した上で、逐次増産に対応できるよう製造設備を導入し、順次生産を開始できる体制を構築することを目的としております。

当社及び当社子会社である SUMCO TECHXIV 株式会社による総額 2,287 億円の設備投資について

当社及び当社子会社である SUMCO TECHXIV 株式会社は、2021 年 9 月 30 日に総額 2,287 億円の設備投資を決定いたしました。当社グループの国内既存建屋内の増産スペースが尽きていることから、300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの逐次増産を継続し、供給責任を果たすため、当社において新たな建屋、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。併せて当社子会社である SUMCO TECHXIV 株式会社においても、建屋の増築、ユーティリティ設備及び製造設備にかかる設備投資の実施を決定いたしました。今後 2022 年より建屋の建設及びユーティリティ設備の設置を進め、2023 年からは製造設備を導入のうえ順次生産を開始し、2023 年内には SUMCO TECHXIV 株式会社の、2024 年内には当社の本設備投資の完了を予定しております。

（なお、2024 年末までの両社の設備投資が本設備投資に限られるわけではありません。）

今般新たな建屋及びユーティリティ設備を導入することで、今後数年にわたり複数回の逐次増産に対応する設備投資を行うことが可能となります。

当社グループの主な設備投資計画の内容は、2021 年 9 月 30 日現在、以下のとおりとなっております。

会社名	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
		投資総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社 (株式会社 SUMCO)	300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備（建屋及びユーティリティ設備の建設に関連する設備投資）	78,600	—	増資資金	2021 年 10 月	2023 年 12 月	— (注) 2
提出会社 (株式会社 SUMCO)	300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備（製造設備に関連する設備投資）	122,900	—	増資資金及び自己資金	2021 年 10 月	2024 年 12 月	— (注) 2

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

会社名	設備の内容	投資予定額		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後の増加能力
		投資総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
SUMCO TECHXIV 株式会社	300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備（建屋及びユーティリティ設備の建設に関連する設備投資）	16,500	—	自己資金及び借入金 (注) 1	2021年 10月	2023年 12月	— (注) 2
SUMCO TECHXIV 株式会社	300mm 半導体用最先端シリコンウェーハの対応設備（製造設備に関連する設備投資）	10,700	—	自己資金及び借入金 (注) 1	2021年 10月	2023年 12月	— (注) 2

(注) 1 提出会社（株式会社 SUMCO）からの子会社投融資

2 完成後の生産能力を合理的に見積もることは、困難であるため記載しておりません。

当社グループの台湾拠点における今後の設備投資について

当社グループは、今後も旺盛な需要の増加に対応するため、継続的な逐次増産が必要になると見込んでおります。顧客からの需要の増加に対応すべく、台湾においても供給責任を果たすために市場の成長に見合った段階的な増産を検討してまいります。国内の製造拠点と同様に、台湾の製造拠点においても既存建屋における生産能力は限界に達しております。従って台湾においても増産を継続する場合、新たな建屋及びユーティリティ設備の建設に伴う追加投資が必要になる見込みです。これについて、適時開示が必要な事象が生じた場合には速やかに開示いたします。なお、当該追加投資が必要となった際の資金調達手段は未定であり、また、今回の国内一般募集及び海外募集による手取金を充当するものではありません。

(2) 前回調達資金の使途の変更

該当事項はありません。

(3) 業績に与える影響

今回の資金調達により、中長期的な企業価値向上の実現を支える財務健全性を維持・向上させつつ、顧客との長期契約に基づく需要の増加に応じて最先端ウェーハの逐次増産を継続することで、当社の中長期的な利益成長及び当社が強みを有する最先端ウェーハ市場における競争優位性の更なる強化に資するものと考えております。なお、今回の資金調達が 2021 年 12 月期の当社グループの業績に与える影響は軽微です。

3. 株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当に関しては、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、及び、設備投資等の資金需要や内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、柔軟かつ積極的な株主還元を実施していく方針であります。当社グループは、財務体質の改善により、2015 年の公募増資時に掲げた自己資本比率 50%以上、グロス D/E レシオ 0.5 倍以下とする中期財務目標を 2019 年末に達成いたしましたので、株主還元策を見直し、従前からの連結配当性向約 30%に加え、2019 年 12 月期及び 2020 年 12 月期については自己株式の取得により更に約 10%の株主還元を実施しております。なお、2021 年 12 月期の期末配当及び自己株式取得については未定です。

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

(2) 配当決定に当たっての考え方

当社は、剰余金の配当、自己株式の取得等、会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

当社は、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し期末配当を、毎年 6 月 30 日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(3) 内部留保資金の用途

内部留保資金は設備投資、研究開発投資などに充当し、事業基盤の安定と企業価値の向上に努めてまいります。

(4) 過去 3 決算期間の配当状況

	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期
1 株当たり連結当期純利益	199.74 円	112.90 円	87.48 円
1 株当たり年間配当金 (内 1 株当たり中間配当金)	62.00 円 (30.00 円)	35.00 円 (25.00 円)	27.00 円 (18.00 円)
実績連結配当性向	31.0%	31.0%	30.9%
自己資本連結当期純利益率	22.3%	11.3%	8.3%
連結純資産配当率	6.9%	3.5%	2.6%

(注) 1. 実績連結配当性向は、1 株当たり年間配当金を 1 株当たり連結当期純利益で除した数値です。

2. 自己資本連結当期純利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、自己資本（連結純資産額合計から非支配株主持分を控除した額で期首と期末の平均）で除した数値です。

3. 連結純資産配当率は、1 株当たりの年間配当金を 1 株当たり連結純資産（期首と期末の平均）で除した数値です。

4. その他

(1) 配分先の指定

該当事項はありません。

(2) 潜在株式による希薄化情報

該当事項はありません。

(3) 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

①過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況

該当事項はありません。

②過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	2018 年 12 月期	2019 年 12 月期	2020 年 12 月期	2021 年 12 月期
始 値	2,995 円	1,151 円	1,779 円	2,300 円
高 値	3,345 円	1,950 円	2,484 円	2,954 円
安 値	1,128 円	1,116 円	1,041 円	2,111 円
終 値	1,227 円	1,826 円	2,263 円	2,274 円
株価収益率	6.14 倍	16.17 倍	25.87 倍	一倍

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

- (注) 1. 株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 2021年12月期の株価等については、2021年9月29日(水)現在で記載しております。
3. 株価収益率は決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり連結当期純利益で除した数値であります。なお、2021年12月期については未確定のため記載しておりません。

③過去5年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等
該当事項はありません。

(4) ロックアップについて

国内一般募集及び海外募集に関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、発行価格等決定日に始まり当該募集に係る受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間(以下「ロックアップ期間」といいます。)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換され得る有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただし、国内一般募集、海外募集及び株式分割による新株式発行等を除きます。)を行わない旨を合意しております。

上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中であってもその裁量で、当該合意の一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

以 上

ご注意：この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出目論見書及びその訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。